

公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMP とその応用技術専門委員会
第 204 回研究会開催のご案内

このたび、プラナリゼーションCMP 専門委員会では、下記の通り第 204 回『総会・特別講演会』研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。是非ご参加下さい。



日 時：2023年3月1日(水) 12:40～17:00 / 17:30～19:30 情報交換会

開催場所：研究会中央大学・後樂園キャンパス 2F 2221 号室 (製図室)

情報交換会：後樂園ドームホテル 42F「オリオン」にて (添付地図参照)

※完全対面にて開催致します。

※オンサイト会場の詳細については最終ページをご覧ください。

※開催日 2 日前の 2 月 27 日午前中までに必ず事前登録をお願い致します。

※研究会、情報交換会どちらも必ず事前参加登録をお願いします。

プログラム：

1. 12:40～12:45 開会挨拶 (檜山委員長)
2. 12:45～13:20 総会
3. 特別講演 (13:20～17:00) / 質疑応答含

1) 13:20～14:20 「Innovative CMP Technology for the Evolution of Flash Memory Device」

Kihoon Jang, Changsun Hwang, Boun Yoon

Flash Process Development Team, Semiconductor R&D Center, Samsung Electronics

<概要> The main structure of the flash memory could be classified in to four categories with the evolution of the device. Starting from the 2D planar type, the structure had changed to 3D VNAND to Cell Over Peripheral (COP) and nowadays to Bonding VNAND. Chemical Mechanical Planarization (CMP) technology and various types of CMP materials such as slurry, chemical and equipment were also developed to meet the specific performance of each structure. I would like to introduce three technologies among the CMP technology in the flash device.

2) 14:20～15:10 「3次元フラッシュメモリにおける平坦化プロセス技術課題」

キオクシア株式会社 中嶋 一明氏

<概要> 市場からのメモリ大容量化・高速化要求に応えるべく、3次元フラッシュメモリ開発では、世代を追うごとに高積層化や多層配線化を進めています。それにとめない平坦化プロセスに求められる性能指標も高く、メーカ協業のもと新たなスラリ材料開発からハード開発まで多岐に渡り取り組んでいます。本発表では、高段差構造の平坦化プロセスなど3次元フラッシュメモリ特有な技術課題について報告いたします。

.....
15:10～15:20 休憩
.....

3) 15:20～16:10 「半導体産業の利益率はどうして高いのか？」

株式会社レゾナック 近藤 誠一氏

<概要> 半導体産業の営業利益率はデバイスメーカーのみならず、装置・材料メーカーも含めて非常に高いことは一般に良く知られている。特に半導体前工程に関わっている会社や事業部門では20%以上の営業利益率を達成していることが普通であり、好景気には30～60%にもなる場合がある。一方、自動車産業は一般的に10%以下であることが多く、自動車部品・材料メーカーに至るまで同様である。これは会社や時期に依存することはあっても、それが主たる理由ではなく、産業構造の違いによるものであ

ることを議論したい。

4) 16:10～17:00 「半導体産業の成長ロードマップはさらに加速してゆく新段階
～メタバース、SDGs 革命、次世代自動車が開花してくるのだ！」

株式会社産業タイムズ社 泉谷 渉氏

<概要>半導体産業はここに来て、ある種の踊り場状況となっている。もしかして、今や経済安全保障のカギを握っている半導体はさらにその重要性を増しているのだ。各国は開発、投資ともに将来へ向けての支援策に全力を上げて取り組みはじめた。前工程の先端投資に加えて、後工程の革新も必要であり、SDGs 革命が装置の分野まで及んで来ている。メタバースは間違いなく第4の IT ウェーブであり、エッジコンピューティングを含めて、半導体のあらたなリード役になろうとしている。今回講演では、ファンドリーの投資急増、パワー半導体の新增設、自動車用半導体の最新版そして日本および世界の半導体支援策などを最新取材をベースに報告する。

17:00～ 連絡事項・閉会挨拶

17:30～19:30 情報交換会 後楽園ドームホテル 42F 「オリオン」 (徒歩 15 分の移動)

参加費

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円） ※2 名迄無料、3 名以上は 3,000 円/1 名
2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録
3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）
※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。
※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

2023 年 3 月 1 日（金）第 204 回研究会参加申込書

第 204 回研究会 情報交換会

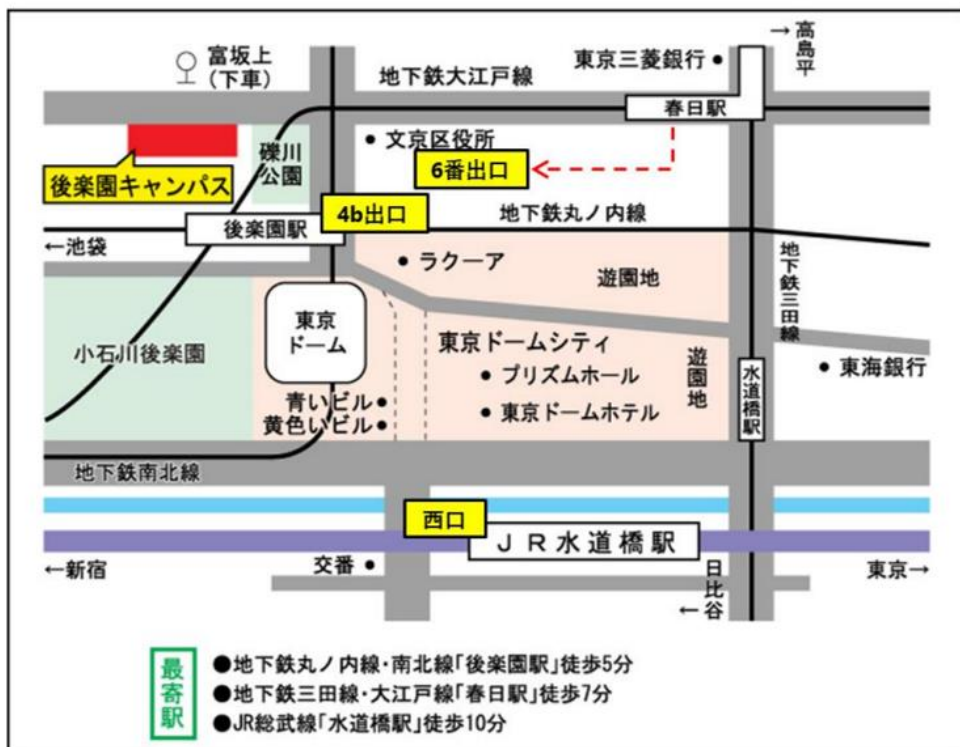
氏名			
勤務先・所属	k		
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		

※ホームページからオンライン申し込みできます。

<http://www.planarization-cmp.org/registration>

問合せ先：「プラナリゼーション CMP 専門委員会」事務局（三上）
TEL：03-5962-3145, FAX：03-5962-3146, e-mail：mikami@global-net.co.jp

プランリゼーション CMP 専門委員会 (2023.3.1) 会場案内



● 後楽園キャンパス

〒112-8551 文京区春日1-13-27

情報交換会：後楽園ドームホテル 42F

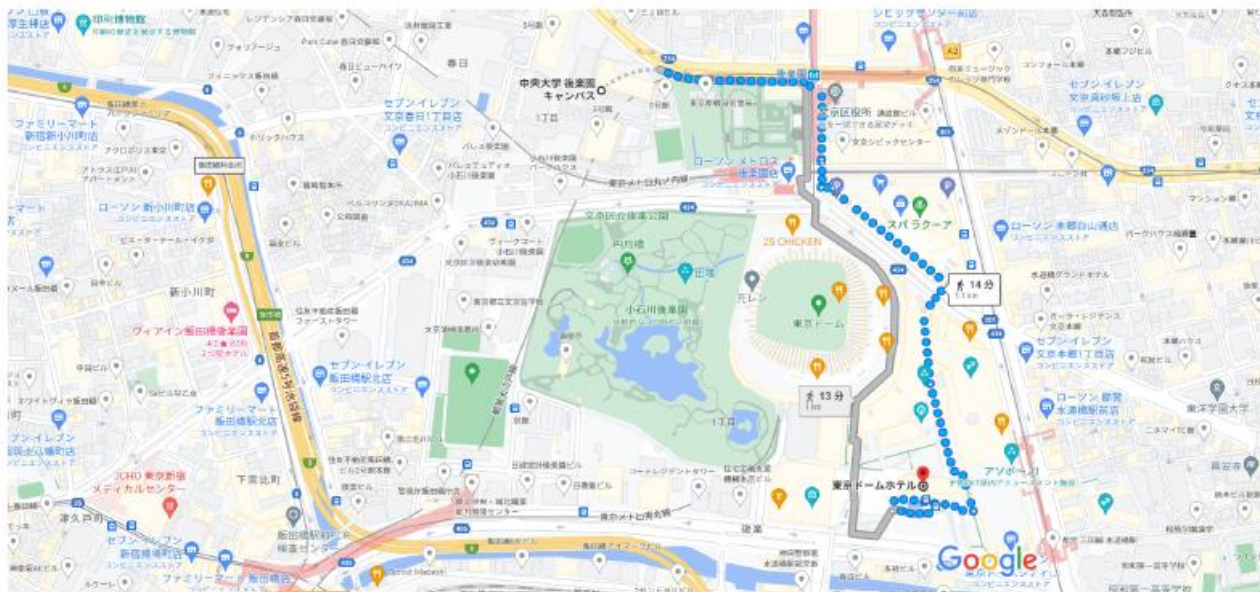
「オリオン」にて17:30~19:30

2023/01/18 10:25

中央大学 後楽園キャンパス から 東京ドームホテル - Google マップ



中央大学 後楽園キャンパス、〒112-8551 東京都文京区春日1丁目13 徒歩 1.1 km、14分
- 27 から 東京ドームホテル、〒112-8562 東京都文京区後楽1丁目3-6 1



地図データ ©2023 Google 100 m



富坂/春日通り/国道254号 経由 14分
1.1 km



富坂/春日通り/国道254号 と 外堀通
り/都道405号 経由 13分
1.0 km